

# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 07022601  
 PUBLICATION DATE : 24-01-95

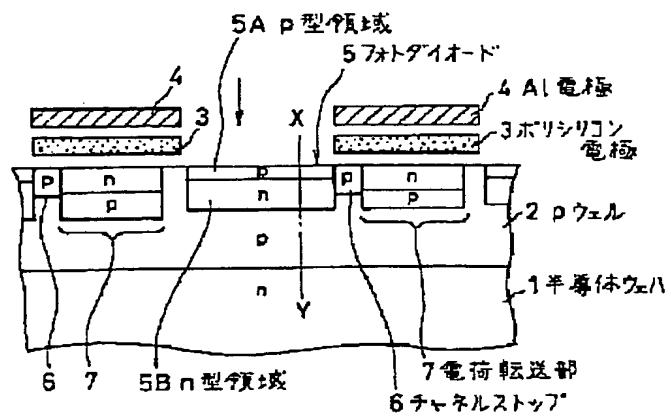
APPLICATION DATE : 23-06-93  
 APPLICATION NUMBER : 05151672

APPLICANT : SONY CORP;

INVENTOR : MATSUNO TOMOYUKI;

INT.CL. : H01L 27/148 H04N 5/335

TITLE : MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE



**ABSTRACT :** PURPOSE: To make constant a substrate voltage between semiconductor substrates by a method wherein a dose of impurity is corrected by an ion implantation so as to make a stored electric charge amount in an electric charge store part a set value by measuring resistivity of the semiconductor substrate.

CONSTITUTION: Resistivity of a sheet of wafer in a lot to be initially processed is measured. Next, a dose of n-type impurity of a wafer is calculated based on a measured value. Next, a dose of p-type impurity of a p well 2 is decided from the dose of the n-type impurity of the wafer. The dose of the p-type impurity is decided according to the relation of potential and a photodiode 5 formed in the p well 2, and decided so that an electric charge store amount in an electric charge store part can be made constant. Next, an ion implantation is controlled to form the p well so that the entire wafer of lots can become an appropriate dose. Thus, a substrate voltage can be non-regulated and also stabilized.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-22601

(43)公開日 平成7年(1995)1月24日

(51)Int.Cl.\*

H 01 L 27/148  
H 04 N 5/335

識別記号 庁内整理番号

Z

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 ○ L (全 4 頁)

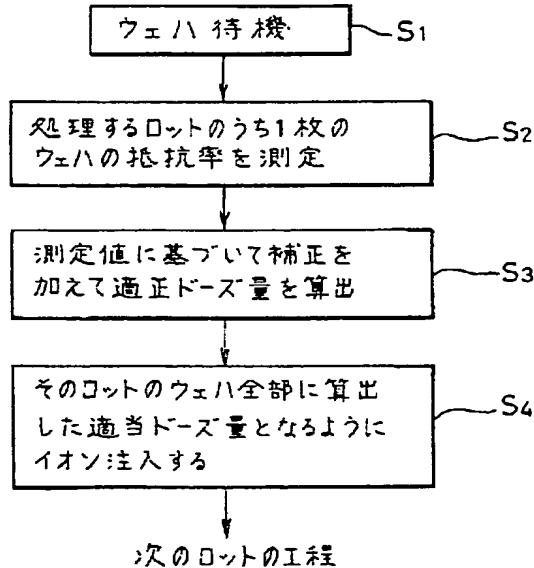
(21)出願番号	特願平5-151672	(71)出願人	000002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号
(22)出願日	平成5年(1993)6月23日	(72)発明者	松野 知之 長崎県諾早市津久菜町1883-43 ソニー長崎株式会社内
		(74)代理人	弁理士 志賀 富士弥 (外1名)

(54)【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】 基板電圧 ( $V_{bb}$ ) 無調整化できる半導体装置の製造方法を提供する。

【構成】 ウェルをイオン注入で形成する前に、ロットのうち1枚のウェハの抵抗率を測定し、その測定値に基づいて、ウェハの適性ドーズを算出する。この算出ドーズ量となるように、全ウェハのウェルのイオン注入を行う。他のロットも同様のことを行う。このようにすることにより、ウェハの基板電圧を安定化することが可能となる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板にイオン注入を行ってウェルを形成し、該ウェルに電荷蓄積部を形成する半導体装置の製造方法において、

前記半導体基板の抵抗率を測定し、該抵抗率の測定値に基づいて、該電荷蓄積部の蓄積電荷量が設定量になるように、前記イオン注入による不純物のドーズ量に補正を加えてウェルを形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】 この発明は、半導体装置の製造方法に関し、特に、半導体基板にウェルが形成される半導体装置の製造分野で利用することができる。

## 【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】 従来、ウェルが形成される半導体装置として例えば固体撮像デバイスがある。図3は、n型半導体ウェハに形成された、縦型オーバーフロードレイン構造をもつCCDイメージセンサの断面説明図である。同図中、1はn型の半導体ウェハであり、このウェハ1にはイオン注入によってpウェル2が形成されている。また、pウェル2の表面には、絶縁膜(図示省略する)を介してポリシリコン電極3、A1電極4が所定のパターンに形成されている。そして、pウェル2の、電極パターンの間の領域に、受光部としてのフォトダイオード5が形成されている。このフォトダイオード5は、pウェル2の表面側から内部に向けてp型領域5Aとn型領域5Bとが順次形成されてなる。フォトダイオード5の一側部には、チャネルトップ6が形成されている。また、ポリシリコン電極3の下方には、チャネルトップ6に隣接して電荷転送部7が形成されている。図4は、図3に示す線X-Yで切った部分のボテンシャルプロファイルを示している。この図から判るように、図3に示すn型領域5Bに電荷が蓄積するようになっている。ここで、図4に示すように、pウェル2部分のボテンシャルエネルギーを $\phi_{p\text{well}}$ とし、図5に示すように、各接合部の空乏領域の容量を $C_1$ 、 $C_2$ 、 $C_3$ とする。従来、 $\phi_{p\text{well}}$ は、蓄積電荷量 $Q$ を一定化するため、この $\phi_{p\text{well}}$ をチップ毎に基板電圧( $V_{bb}$ )で調節している。この $\phi_{p\text{well}}$ に対する最も大きなパラメータは、図5に示す容量 $C_3$ である。この容量 $C_3$ を決定する要因は2つある。一つは、pウェル2の不純物のドーズ量であり、他の一つは、n型半導体ウェハ(n<sub>bb</sub>)1の不純物のドーズ量である。このうち、pウェル2のドーズ量は、イオン注入によって制御されているのに対し、より空乏層の広がるn型半導体ウェハ1のドーズ量は値に幅をもっており、基板電圧( $V_{bb}$ )の安定化という点では管理されていないに等しかった。図6に示すように、引き上げたインゴット1の下端側A、中間部B、上端側Cの部分からスライスさ

れるウェハにおけるドーズ量は微妙に異なっている。これは、ドーズ量がある幅で分布するためである。1つのインゴットから作成されるウェハの抵抗率と基板電圧( $V_{bb}$ )との関係を示したグラフである。このグラフから判るように、抵抗率に誤差幅をもっている。例えば、n型不純物のドーズ量が低い場合は、抵抗率が大きくなり、基板電圧( $V_{bb}$ )値は大きくなる。このように、このドーズ量により、基板電圧が変化し、 $V_{bb}$ 値が不安定となる問題があった。

10 【0003】 この発明が解決しようとする課題は、基板電圧の安定した半導体装置を製造するには、どのような手段を講じればよいかという点にある。

## 【0004】

【課題を解決するための手段】 この発明は、半導体基板にイオン注入を行ってウェルを形成し、該ウェルに電荷蓄積部を形成する半導体装置の製造方法において、前記半導体基板の抵抗率を測定し、該抵抗率の測定値に基づいて、該電荷蓄積部の蓄積電荷量が設定量になるように、前記イオン注入による不純物のドーズ量に補正を加えてウェルを形成することを、解決手段としている。

## 【0005】

【作用】 この発明においては、半導体基板の抵抗率の測定値からウェルのドーズ量が決定され、電荷蓄積部の蓄積電荷量が設定量となる。この設定量は、半導体基板間で同じであり、ウェルのイオン注入を制御することで作ることができる。このため、半導体基板間で基板電圧( $V_{bb}$ )を一定にすることができます。

## 【0006】

【実施例】 以下、この発明に係る半導体装置の製造方法を図面に示す実施例に基づいて説明する。

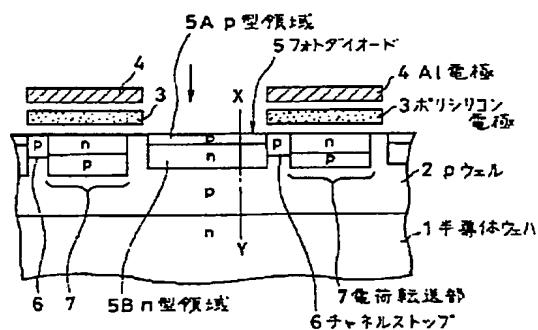
30 【0007】 本実施例は、半導体装置としてのCCDイメージセンサの製造に本発明を適用した例である。まず、本実施例の方法では、図1に示すように、インゴットから切り出された例えばn型のウェハ(半導体基板)を1ロット25枚として複数のロットをイオン注入装置に投入するために待機させる。(ステップS<sub>1</sub>)。

【0008】 次に、最初に処理するロットのうち1枚のウェハの抵抗率を測定する(ステップS<sub>2</sub>)。次に、この測定値に基づいて、ウェハのn型不純物のドーズ量を算出する。そして、ウェハのn型不純物のドーズ量から図3に示すpウェル2のp型不純物のドーズ量を決定する(ステップS<sub>3</sub>)。このp型不純物のドーズ量は、pウェル2に形成されるフォトダイオード5とのボテンシャルの関係で決定され、電荷蓄積部(n型領域5B)の蓄積電荷量を一定(設定値)にするよう決める。

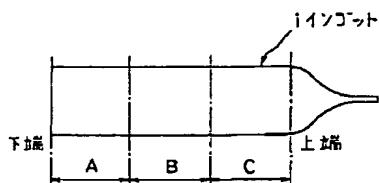
【0009】 図2は、ウェハどうしの抵抗が $a > b$ であり、基板電圧( $V_{bb}$ )が $a > b$ の2つのCCDイメージセンサのボテンシャルプロファイルを示したものである。この図から判るように、 $a = b$ つまり $V_{sub}$ 値を同じにするには、pウェルの不純物ドーズ量を下げれば



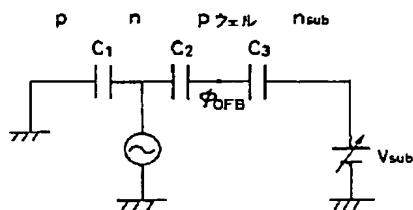
【図3】



【図6】



【図5】



【図7】

